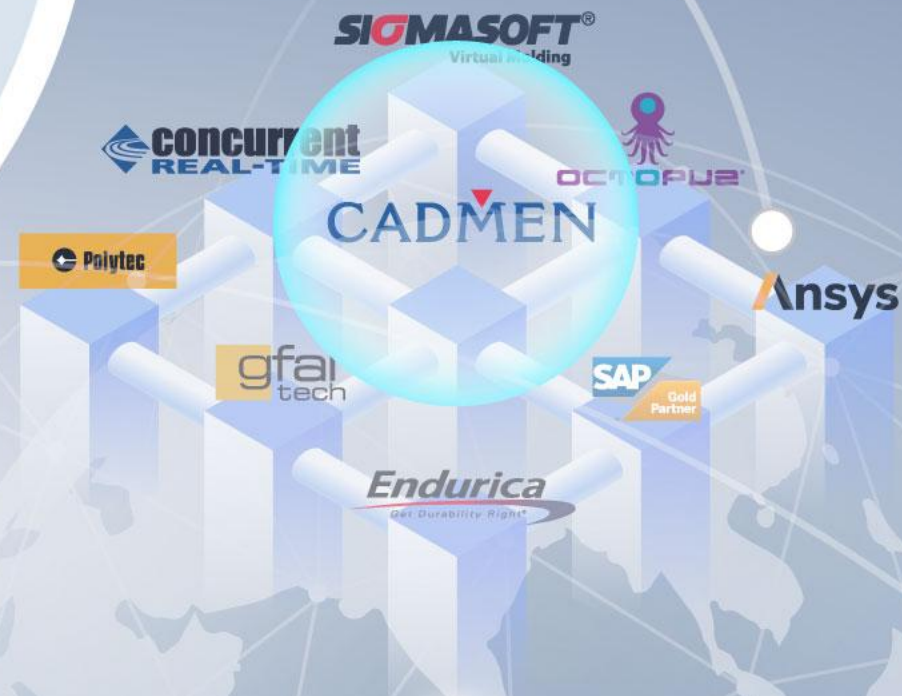


CAD MEN
Taiwan Auto-Design Co. (TADC)

虎門科技(股)有限公司
Taiwan Auto-Design Co.(TADC)

報告人：
楊涪嵐 Frances

股票代號
6791



CAD MEN
Taiwan Auto-Design Co. (TADC)
虎門科技股份有限公司

免責聲明

- 本簡報可能包含對未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。
- 本簡報所所使用的資料來源及各項聲明非常可能受到眾多因素(如：最新科技的演進)的影響而造成迥異，因此本公司強烈建議讀者以參考公開資訊觀測站的公告資訊為依據。

股票代號

6791

議程說明

01 公司介紹

02 產品介紹

03 市場分析及趨勢

04 營運概況

05 研發成果

06 未來發展

公司介紹

PART 01

公司定位

以資訊基礎、協助
產品研發、管理、智慧製造
三個應用整合之技術服務為
核心價值。



CAE

工程模擬分析

提供研發技術服務及整合世界一流分析模擬平台
研發設計優化
提供技術加值

CPC

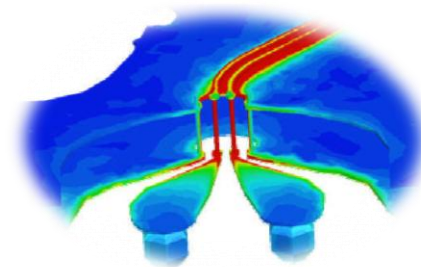
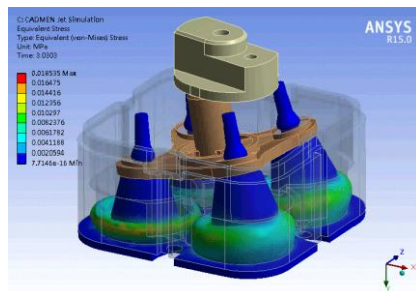
商業管理ERP

提供商用經營管理之全方位整合方案

工業4.0

自動化及智慧化轉型

產業自動化、提供虛實整合方案及系統整合供應鏈



產品介紹

PART 02

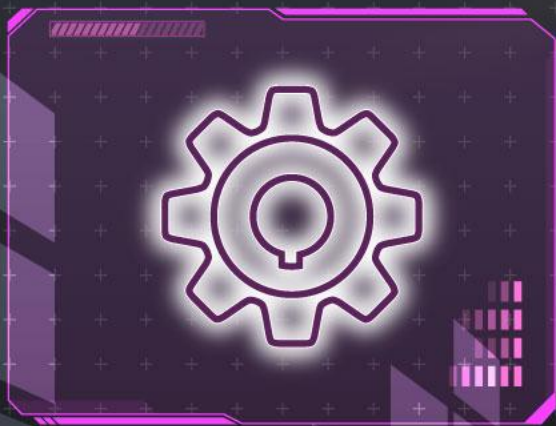
CAE(Computer Aided Engineering 計算機輔助工程)

CAE系統解決方案主係應用於模擬分析、驗證及設計優化，以數值模擬來分析過去受條件限制而無法分析解決的大量且繁複之工程問題，進而提供最佳化之解決方案。本公司主係以40年累積之研發經驗整合國際著名之CAE軟體平台，協助國內產官學研各界於更快速且準確的解決研發設計及分析新產品開發等方面問題。



主力產品 - CAE系統解決方案

CAD MEN 股票代號
Taiwan Auto-Design Co. (TADC) 6791



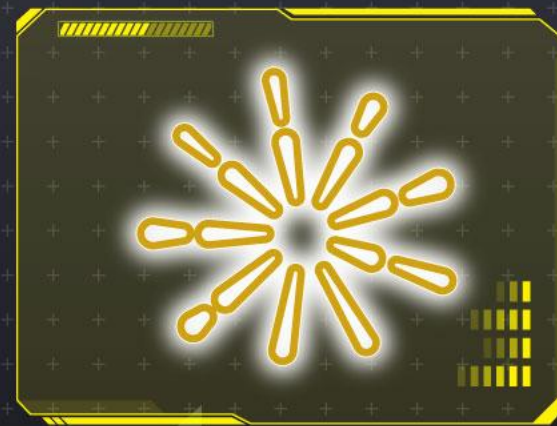
結構



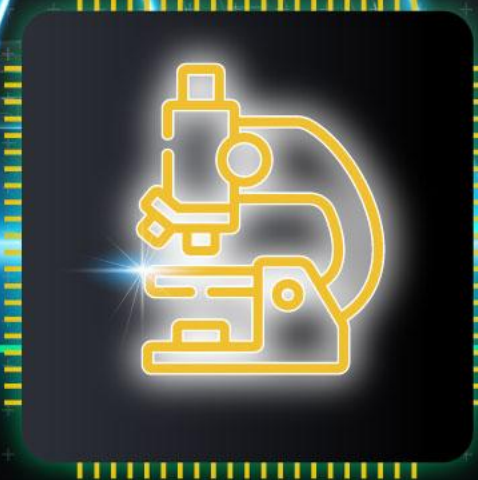
流體



電子設計



光學



高階檢測設備



AI

主力產品 - CAE系統解決方案

計算機輔助工程(CAE)

結構可靠度分析
解決方案

熱流-散熱
解決方案

熱流-潔淨工程與
化工應用解決方案

馬達多重物理系統
設計方案

電力電子
解決方案

無線收發
解決方案

訊號與電源
解決方案

材料結構分析模組
方案 (OptiMa)

3D影像處理
與高階建模

原子級材料
模擬工程

虛擬原型驗證

多領域系統
模擬平台

聲學、振動及光學量測解決方案

聲學照相機
(Acoustic Camera)

WaveCam
振動分析軟體

雷射都普勒量測儀
(LDV)

白光干涉儀
(WLI)

CPC- (Collaborative Product Commerce 協同產品商務)

CPC系統解決方案主係利用網路技術將企業間價值鏈活動之互動、流程整合、組織再造及標準一致化，透過導入SAP系統可有效整合客戶日常營運流程，以發揮整體營運綜效之經營方式。本公司以客戶的核心競爭力為基礎，協助客戶導入嚴謹穩定之SAP系統，以產業別訂作符合標準之模組，累積產業別解決方案之實力。



45%

啟動企業的數位轉型之旅

- ▶ SAP S/4HANA Cloud 導入服務
- ▶ SAP B1導入服務
- ▶ 穩健升級 · 助您前行
- ▶ SAP 系統升級服務

60%

啟動數位革新驅動力

- ▶ SAP BTP平台
- ▶ 顧問服務: 自動化
- ▶ 異質資料整合
- ▶ 資料分析與倉儲
- ▶ AI 智能預測

100%

釋放企業潛力的關鍵

- ▶ 值得信賴的 SAP
- ▶ 技術專家
- ▶ 產業專家



服務項目

01

企業系統導入

ENTERPRISE SYSTEMS

- 雲端 ERP (SAP S/4HANA)
- 人資系統 (HCM) 導入
- 製造執行系統 (MES)
- 系統整合與資料移轉
- 整合測試與上線輔導

02

AMS 應用維運服務

MANAGED SERVICES

- L1.5 / L2 兩級技術支援
- 月結與年結作業支援
- SLA 管理與問題單追蹤
- 系統調校與效能優化
- 關鍵使用者教育訓練

03

AI 與數據應用

AI & DATA

- 營運數據儀表板
- 流程自動化與 AI 應用
- 需求與營運預測分析
- 異常偵測與即時預警
- 持續優化與智慧建議



SAP 雲端 ERP 與企業平台

我們以 SAP S/4HANA Cloud 為企業重建數位核心,並向上延伸為涵蓋 HCM、MES 與數據應用的一體化企業平台。

DIGITAL CORE

以雲端 ERP 打造數位核心

ERP 是企業營運的單一事實來源——財務、供應鏈與生產在同一套系統上即時運作,並成為 HCM、MES 與 AI 應用向上延伸的共同基礎。



以雲端 ERP 重整財務、供應鏈與生產等核心營運流程。



採用 SAP 業界最佳實務,縮短導入時程並降低客製風險。



向上整合 HCM、MES 與周邊系統,讓資料在單一平台流通。



以即時營運數據為基礎,延伸分析儀表板與 AI 輔助決策。

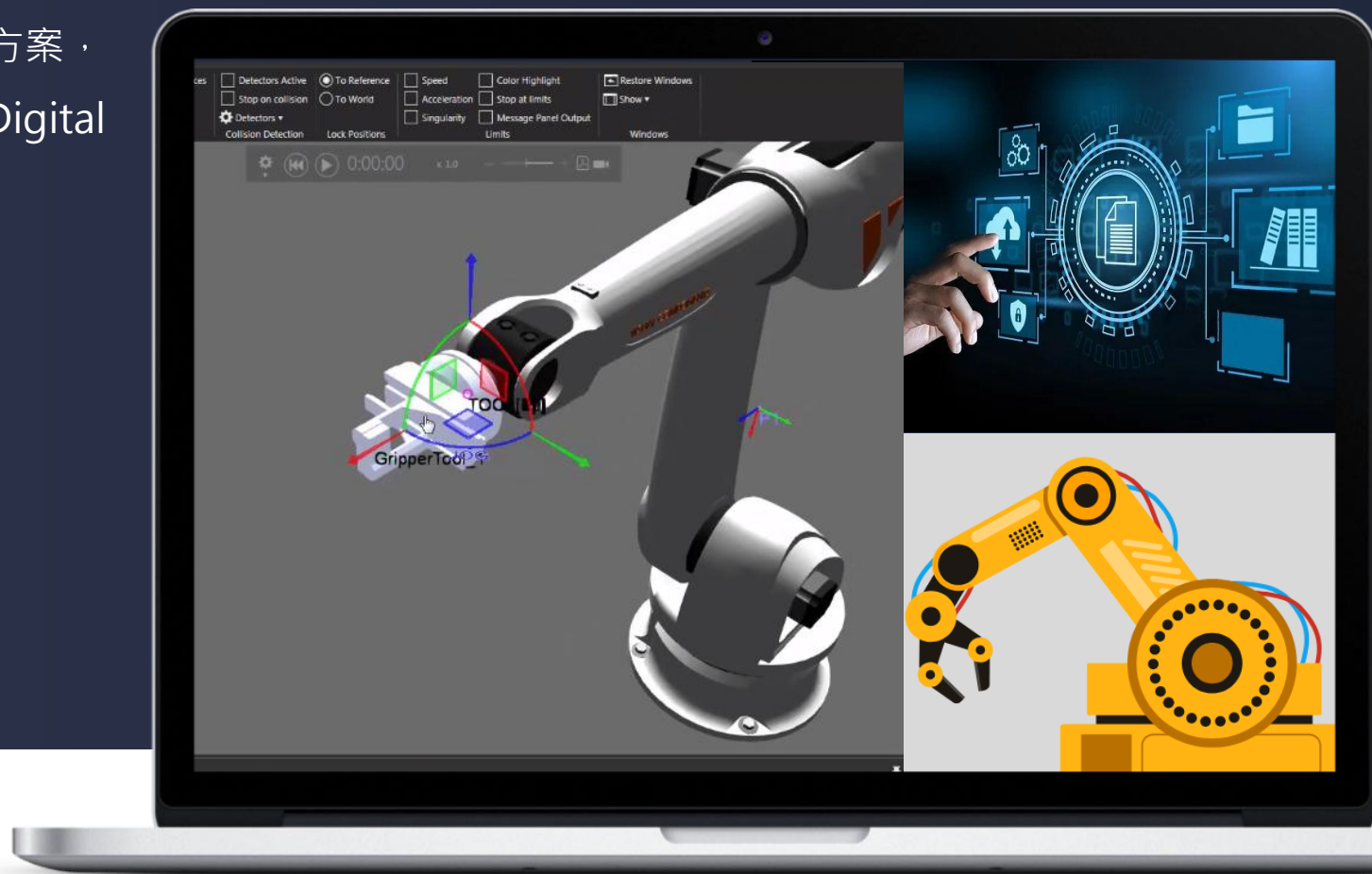


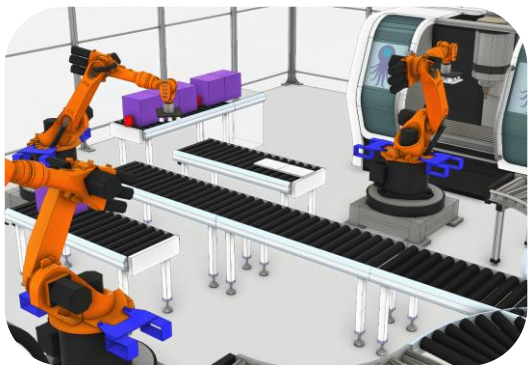
工業4.0

虎門工業4.0 事業部提供工業自動/智慧化解決服務方案，協助客戶導入軟硬體自動化系統，透過虛實整合 (Digital Twin) 縮短設計與整合所需的工時。

包含：

- 自動化系統
- MES製造執行系統 + IoT物聯網
- 機器人離線編程
- 視覺檢測+AI學習
- 機器手臂不斷電系統





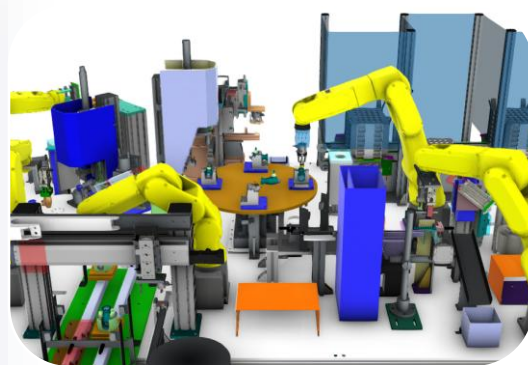
快速提案

大量機器人、無人車等搬運設備的3D規劃模型資料庫，可快速進行方案規劃與評估，協助客戶釐清需求。



設備研發

經驗豐富的研發團隊，透過概念設計、樣品測試、實驗確認，得以加快研發進程並維持良好的設備品質。



虛實整合

透過電腦輔助軟體模擬系統來查察潛在設計風險，使系統節拍與設備間的運作平衡，使生產效率最佳化。



系統製造

執行團隊具備多品牌的機器人與系統設備整合經驗，使系統整合效率提升。

市場分析及趨勢

PART 03



“

- 本公司具有專業且龐大之工程師顧問服務團隊，
累積30年技術知識庫能根據客戶的產業、產品、問題需求，在時效內給予相對應的系統解決方案。
- 客戶群涵蓋電子業滲透率超過80%、學界涵蓋率超過95%、公私立機關與財團法人。
- 台灣半導體龍頭指定服務商。
- 台灣區唯一直接與總部下單的**菁英級代理商**(Elite Channel Partner,最高等級)。

”



- 自2005年SAP台灣區首批代理商以來，虎門科技深耕**國內中小企業市場**。
- 自研**開發專屬SAP B1模組管理**，以符合台灣地區管理所需之解決方案。
例如.媒體申報，電子發票，票據，存貨三表，批次生產，品管..等解決方案。
- 客戶為減低投資成本，實現實務管理需求，我們採化整為零的整合服務輸出。
- 虎門科技CPC部門獲得SAP B1台灣區-**年度最佳貢獻獎**的肯定。
- 2024年**組建S4顧問團隊**，跨足大型模組市場。



- 業界少見 能同時提供產品設計與開發、精密加工、工廠數位孿生、產線自動化、AI導入、MES、IOT與SPC的整體解決方案顧問團隊。

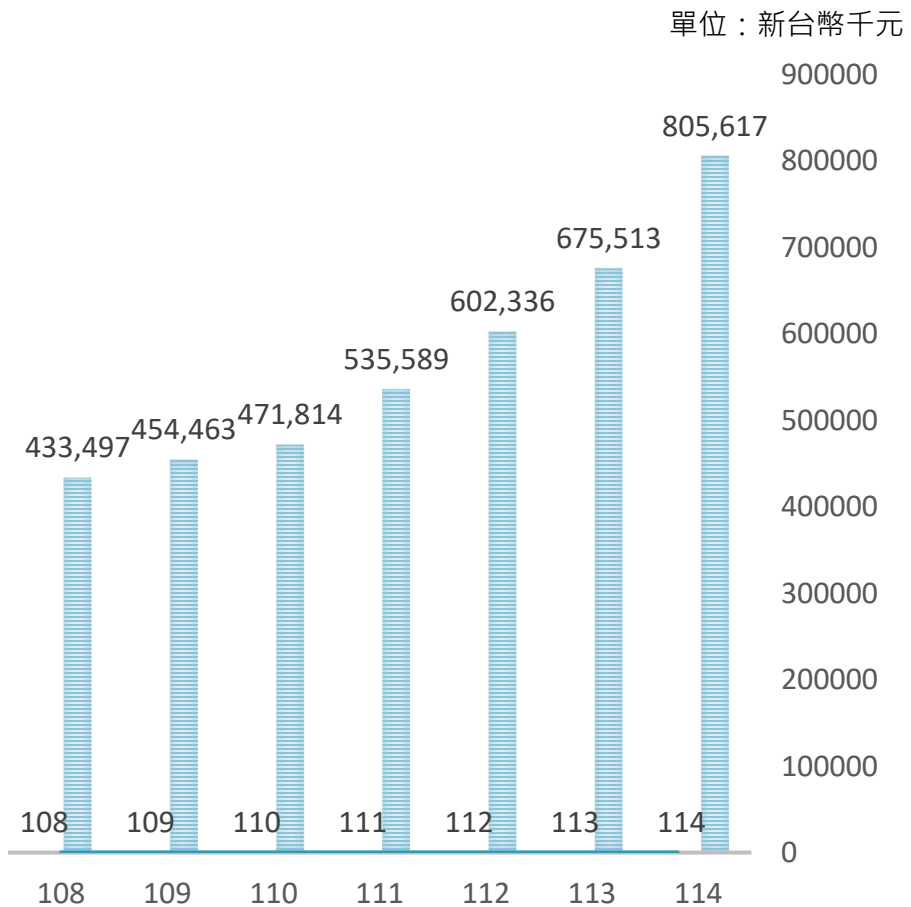
近期實績：

- 完成**伺服器產業**與**光通訊產業**自動化設備開發。
- 完成**AI 視覺**與**靈巧手**自動化設備研發。
- 完成半導體**倉儲物流**設備開發。
- 完成半導體**FFU**與周邊自動化組裝線開發。
- 完成半導體**Thermal PAD** 自動化貼片開發，業界良率最高。
- 提供建築行業自動化解決方案，環保減碳、高效。

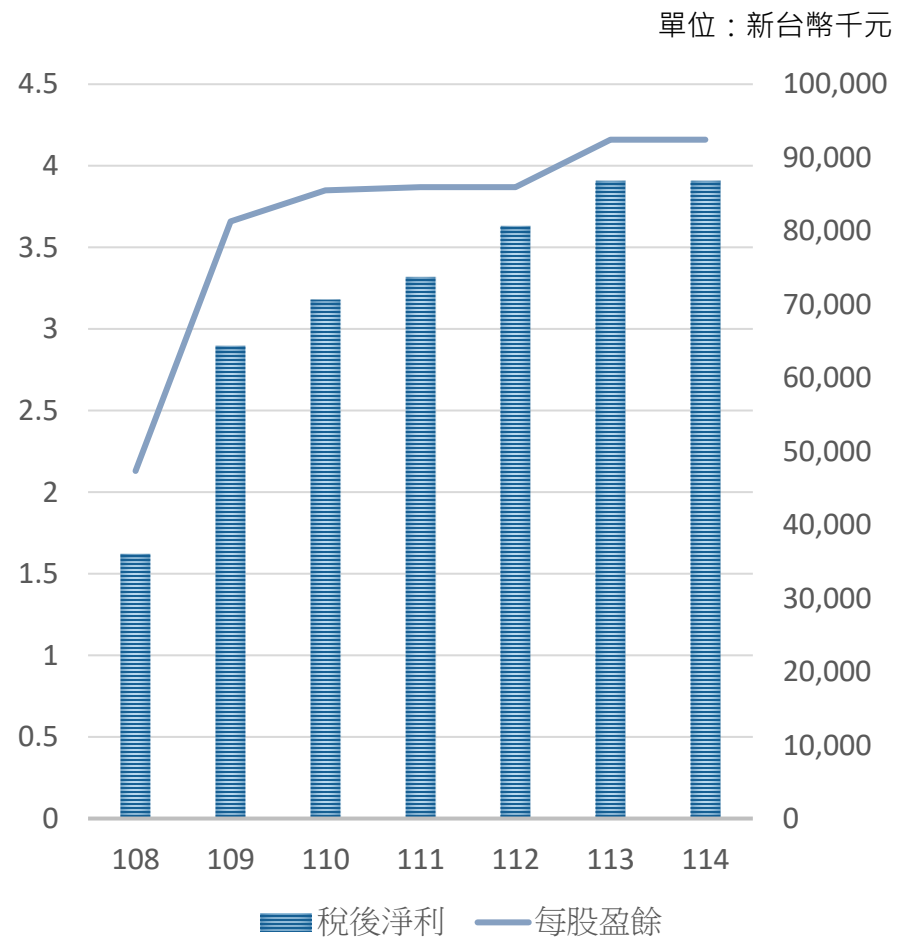
營運概況

PART 04

歷年營收成長



歷年稅後淨利及每股盈餘



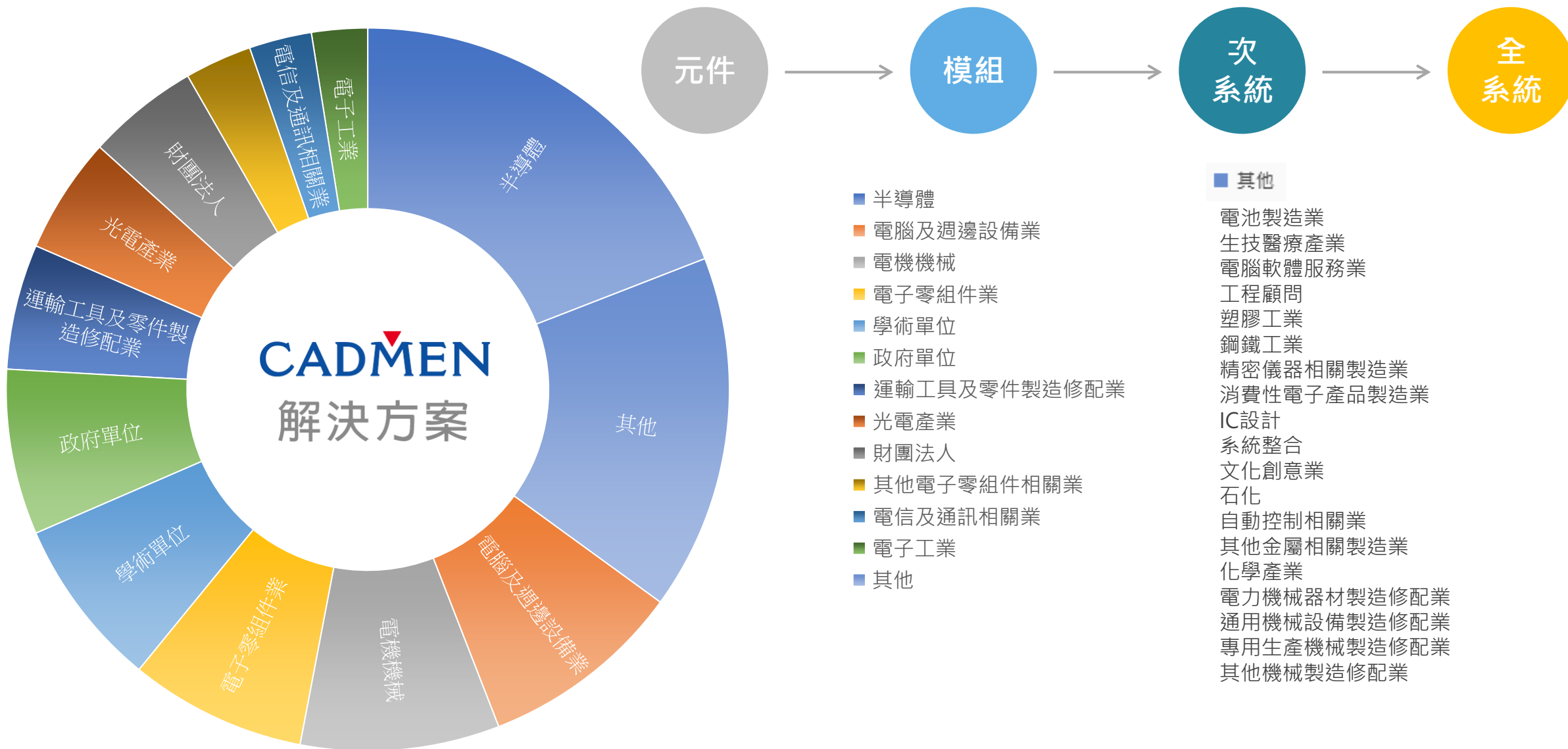
最近三年簡明資產負債表

會計項目	112年12月31日		113年12月31日		114年12月31日		115年3月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產	557,190	75	614,400	73	671,550	78	705,592	78
非流動資產	188,821	25	233,396	27	203,591	22	205,483	22
資產總額	746,011	100	847,796	100	875,141	100	905,219	100
流動負債	254,072	34	339,767	40	322,679	38	402,325	44
非流動負債	32,215	4	32,213	4	28,336	3	23,874	2
負債總額	286,287	38	371,980	44	351,015	41	426,199	46
權益總額	459,724	62	475,816	56	524,126	59	484,876	54
負債及權益總計	746,011	100	847,796	100	875,141	100	905,219	100

最近三年簡明損益表

會計項目	112年度		113年度		114年度		115年度第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	602,336	100	675,513	100	805,617	100	201,630	100
營業毛利	246,149	41	259,427	38	330,480	41	84,062	42
營業費用	159,855	27	175,751	26	246,897	31	52,948	26
營業外收入及支出	11,662	2	23,148	3	24,359	3	10,222	5
稅前淨利	97,956	16	106,824	15	107,942	13	41,336	21
稅後淨利	80,605	13	86,824	13	86,815	11	34,164	17
每股盈餘	3.87		4.16		4.16		1.64	
現金股利配發	3.46940068		3.48141953		3.50224411			



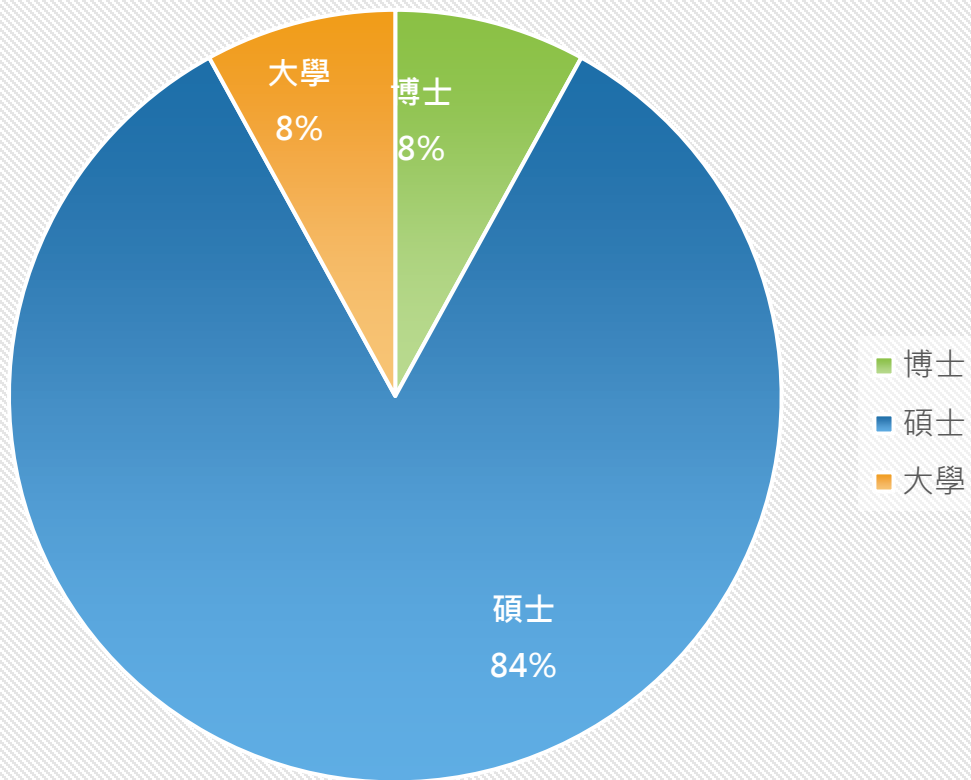


研發成果

PART 05

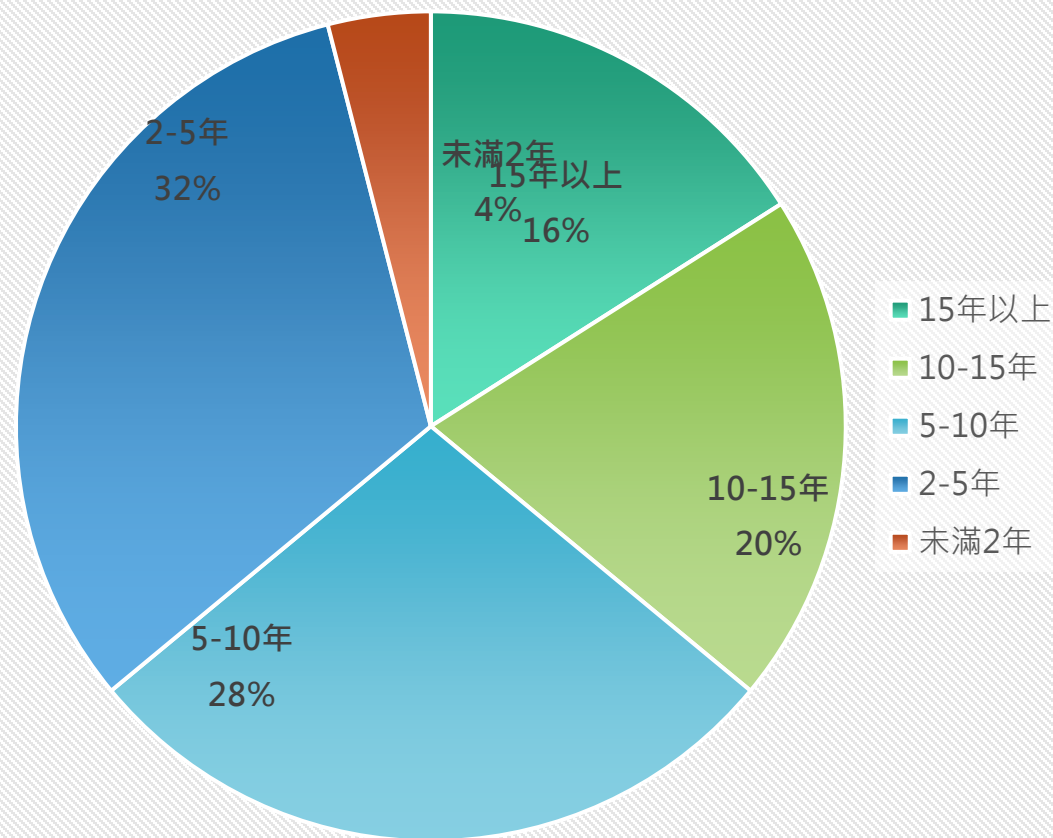
研發人員素質分析

研發人員學歷分佈



截至2026年4月30日之員工資訊
>90%具有碩博士學歷

研發人員產業總年資



截至2026年4月30日之員工資訊
5年以上約64%

技術優勢及競爭利基

深耕系統解決方案市場

本公司投入此市場較早，已累積大量的成功案例及客戶群，故有此領域最需要的「方法」及「產業經驗」，與客戶黏著度高 (>80%的回購率)。

提供全方位解決方案及線上教學影片

由於各產業研發技術涉及各種應用層面，唯有「整合」方能有效提供解決方案以達到客戶需求；另，本公司在提供解決方案時亦提供相關流程及線上教學影片，使客戶更仰賴本公司之技術及服務。

最短時間內提供設計結果

本公司投入此市場較早，已累積大量的成功案例及客戶群，故有此領域最需要的「方法」及「產業經驗」，與客戶黏著度高
本公司具備多耦合物理場技術並累積大量開發技術知識庫，且擁有多元的碩博士學歷工程師群 (機械/航太/化工/化學/造船/電機電子)，經過長期培養可更**快速解決客戶問題**，大幅縮短客戶在開發上所需花費之時間及人力成本，此為最大之競爭利基。

系統設計彈性，加速客戶新產品開發週期

運用**多重物理系統設計平台**及透過標準化流程與大數據數位化，使產品設計可視化及可預測化，除縮短開發週期，進而提升新產品性價比，並創造創新價值，並與競爭同業做出技術上的區隔。

工作項目	執行情形與預期效益說明
ML Analyzer	<p>本平台建構通用型機器學習分析架構，涵蓋資料處理、特徵工程及模型建構等核心功能，提供完整之數據分析與建模流程。透過模型化分析技術，協助企業進行關鍵參數預測與關聯性探索，強化數據驅動決策能力。</p> <p>應用範圍涵蓋半導體製程最佳化及製藥產業配方與製程分析等多元場域，具備高度產業應用彈性。</p>
半導體產業幾何模型自動化建置技術之開發	<p>提供半導體產業幾何模型建置與自動化解決方案，導入散熱 (Thermal) 與翹曲 (Warpage) 模擬流程，自動生成分析模型並進行熱分佈與結構變形分析，提升模擬分析效率與結果精準度，協助產品設計優化。</p>
紡織產業AI/ML應用技術之開發	<p>運用本公司 ML Analyzer，提供雙螺桿擠出製程之AI/ML數據分析服務，針對進料速度、螺桿轉速、溫度設定、壓力變化及扭矩負載等關鍵製程參數進行建模與關聯分析，協助製程參數優化提升製程效率及品質穩定性。</p>
鍊條產業製程與工程模擬應用專用工具	<p>針對鍊條產業產品設計與製程特性，開發工程模擬應用專用工具，用於分析鍊條於實際運轉條件下的受力狀態、接觸行為與運動特性，並評估設計參數對結構強度與運轉穩定性的影響，提升設計評估效率與工程分析能力。</p>
CAE領域<AI知識庫>	<p>彙整工程分析過程之計算資料，並提供搜尋、統計與分析功能，協助使用者於模擬執行過程中掌握關鍵資訊，提升整體計算效率與決策品質，將原本需耗時數天之計算作業縮短至分鐘等級。</p>
馬達驅動控制系統之即時模擬與驗證技術開發	<p>運用 HIL 即時運算平台，提供馬達驅動控制系統之 HIL (Hardware-in-the-Loop) 測試與AI/控制演算法驗證服務，用於控制參數優化、異常狀態模擬與控制策略開發，以提升驅動效率、系統穩定性與動態響應能力。</p>
電池管理系統 (BMS) 之即時模擬與安全驗證技術開發	<p>運用 HIL 即時模擬技術，提供電池管理系統之高精度模型建置與HIL測試解決方案，用於電池狀態估測 (SOC/SOH)、熱管理模擬與故障情境驗證，以提升電池系統安全性、壽命預測準確度及整體能源管理效能。</p>
金屬3D列印技術	<p>以CAE模擬進行金屬3D列印製程設計優化，同時結合國內外金屬3D列印設備廠商，協助客戶進行產業數位轉型。</p>

未來發展

PART 06

強化客戶黏著度，爭取往後每年持續採購之訂單

而本公司具備多元的碩博士學歷工程師群(機械/航太/化工/化學/造船/電機電子)、豐富的解決方案經驗及知識庫，可縮短時間快速提供客戶所需的解決方案

維持良好的服務，並吸引同產業其他客戶

本公司持續再優化模擬的技術，透過經驗的累積，優化及精簡模擬的方法，進而縮短模擬的時程並提高準確度。

掌握科技演進脈絡，第一線陪伴客戶進行各項研究發展

本公司扮演**客戶的研發夥伴**，公司透過與客戶討論解決方案時，可洞悉該產業之未來發展方向，並提早模擬出適合該產業之解決方案，以搶占該產業之發展先機。

提升CAE其他領域 (Non Ansys)

- MedeA：原子鍵構建的材料設計用於新世代材料的調配，特別可提升半導體材料散熱和電學特殊性能。
- Flownex：快速、準確、高效地模擬複雜的熱流動環境，適用於熱流系統的設計和優化，熱流動環境，針對包含氫能系統、AI伺服器水冷系統、儲能櫃散熱系統等，建構虛擬載台進行熱流系統的設計和優化。
- RecurDyn：多體系統動力學模擬軟體，多用於精密高速運動控制設備/模組、機器人和無人載具應用。
- SIGMASOFT：虛擬成型原理的核心是對注射成型中的流動，熱流進行成型優化設計，對於ESG節能需求可更大發揮效益。

模擬結果搭配檢測設備進行驗證

- 透過檢測設備量測材料的物理特性等數據，設計容易使用參數資料，提高模擬分析結果的準確度，提升服務品質，增加服務客戶能量。
- 聲學及振動檢測技術和設備：
Gfai：噪音量測，聲學照相機設備搭配高速攝影機的WaveCam振動進行分析。
Polytec：雷射都普勒(LDV)振動量測設備及材料表面形貌的光學量測系統白光干涉儀(WLI)。

CPC

- SAP S/4HANA 與 BTP的發展，已從「單純 ERP 升級」逐漸轉向「雲端 + AI + 全球營運整合」的數位轉型主軸，尤其在大型製造業、高科技電子業、跨國集團與準上市櫃企業成長最明顯。
- ECC 汰換潮正式進入高峰期
- 中大型企業市場開始加速釋放，對於 ERP 升級、數據平台與 AI 應用需求持續增加
- 切入高成長市場，建立中長期持續性收入與高附加價值服務模式。

工業4.0

- 2026年第二季於南崁租設廠房，除擴大產能外，亦將作為智慧製造示範基地，展示公司在機器人整合、數位孿生及工業4.0領域的核心技術，預期可進一步提升接單能量與國際市場競爭力。本事業群將積極配合客戶全球化布局，拓展美國及墨西哥等製造重鎮之海外市場，藉由水平與垂直整合，提供完整之跨區技術轉導與解決方案，進一步擴大全球市場佔有率。



「 Q & A 意見交流 」



Thank You !

CADMEN
Taiwan Auto-Design Co. (TADC)

/// 想瞭解更多訊息，馬上加入我們 ///



▼虎門
官方網站



facebook



YouTube



LinkedIn

